

令和7年6月26日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会
会 長 嶋田 勇三

第233回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第233回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回は会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和7年7月17日（木）定例講演会 13：00～16：40
技術交流会 17：00～18：00

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第3研修室+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】

（Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）

川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20

<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム：“半導体／PKGの展望および最新技術動向”

(1) 13:00～13:50 プログラムテーマ①	『ウェアラブルデバイスに応用する伸縮FPC（Stretchable FPC）技術』 フレックスリンク・テクノロジー（株） 代表取締役社長 松本 博文 氏 講演内容：ウェアラブルやロボット分野に応用可能な伸縮FPCに関する、デザインおよび機能、信頼性に関して詳解する。
(2) 13:50～14:40 プログラムテーマ②	『DXとGXを支える次世代半導体実装用樹脂・基板材料の開発と技術動向』 一般社団法人エポキシ樹脂技術協会 会長／岩手大学 客員教授／ 横浜市立大学 客員教授 高橋 昭雄 氏 講演内容：通信規格5Gは、IoTやビッグデータ、AIそしてロボットの発展により第4次産業革命の中核を形成しつつあり、5G高度化と2030年頃に予想される6Gに向けて開発が加速している。信号伝送の中核的役割を果たす、プリント配線板等のLSI実装基板には、10GHzを超える高周波領域での低誘電特性と共に超高密度実装に応える高耐熱性、低熱膨張性等の信頼性が要求される。また、GXとして省エネ技術となるSiC、GaNの化合物半導体によるパワーモジュールが注目されており、高耐熱に加えて、高熱伝導性材料への期待が大きくなっている。 開発経験、各社の開発状況を紹介しながら、材料設計の考え方、合成と配合、そして樹脂、基板への応用について報告する。
14:40～14:50	－ 休 憩 －
(4) 14:50～15:20 プログラムテーマ③	『5G・6G向け高周波用銅箔の技術開発動向』 三井金属鉱業（株）機能材料事業本部 銅箔事業部 開発部マーケティンググループ サブリーダー 立岡 歩 氏 講演内容：本講演では、5G・6Gなどの次世代高速通信技術の進展に伴い、通信信号の伝送ロス低減がますます重要となっている。これに対応する高周波用銅箔の技術的課題と最新の開発動向について紹介する。
(5) 15:20～15:50 プログラムテーマ④	『次世代実装に向けたVUV処理による接着・接合技術』 ウシオ電機（株）光プロセスGBU要素開発部 プロセス開発課 シニアエンジニア 有本 太郎 氏 講演内容：生成AIなど社会インフラを担う新技術の爆発的な普及に伴い、データセンタや情報処理機器に対する処理能力への要求は年々高まっている。一方で、半導体の微細化に伴う技術的難易度が製造コストの高騰を招いており、代替手段として半導体パッケージの多層化、高集積化技術に注目が集まっている。次世代半導体パッケージ工程では、従来技術のままでは難しい接着や貼合・接合の課題があり、次世代実装に向けた接着・接合技術に活用が期待されている。同社では、光を軸として表面処理技術（洗浄、表面処理、光加熱など）を保有しており、次世代プロセスへの適応

	を進めている。本講演ではVUV処理技術を中心に、半導体パッケージ工程に対する同社の取り組みについて紹介する。
(5) 15:50～16:40 プログラムテーマ⑤	『半導体産業は2030年まで高成長続く～実装など後工程への投資高まる～』 (株) 産業タイムズ社 取締役会長・特別編集委員 泉谷 渉 氏 講演内容：半導体産業はここにきての拡大機運が高まっている。2025年に世界市場100兆円を突破することは確実であり、2030年までの5年間の平均成長率は年10%と見られている。わが国政府においても、「半導体による国おこし」を打ち出しており、今後5年間で50兆円の官民投資を強烈にリードしていく考えである。こうした情勢下で、シリコン列島ニッポンともいふべき投資ラッシュが続いているが、一方で後工程に対する開発や投資も活発になってきた。ボンディング、パッケージ、チップレット、さらには実装基板に至るまでの工程にスポットライトが当たっている。本講演では、最新取材をベースに世界および国内の半導体産業の動きをレポートする。
17:00～18:00	－ 技 術 交 流 会 － 産業振興会館2階「カフェサウダージ」にて

4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局に問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数人の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。
会員外：22000円／人（不課税）（お申し込み後、請求書をお送りします）

5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場とZoomウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム（<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>）より「お問い合わせ内容」の項目に「第233回定例講演会参加希望」と参加方式（会場もしくはZoom）をご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前とE-mailアドレスもご記入ください。

申込締切日：会 員 令和7年7月8日（火）

会員外 令和7年7月4日（金）

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoomウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※今年度から講演資料は、当会ホームページの会員のページ（<https://www.j-jisso.org/member/>）に講演日までにアップいたします。IDとPWが必要です。講演日前までにご確認ください（企業正会員は貴社連絡担当者にご確認下さい）。今年度より資料の郵送はいたしません。

会員外の方はクラウドで資料共有をいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会 事務局
E-mail：info@j-jisso.org ※E-mail アドレスが変わりました
URL：<http://www.j-jisso.org>